



Halbleiterfertigung bei Bosch

25. Mai 2021

PI 11316 BBM Fi/af

- ▶ **Aktuelles Portfolio** Bosch fertigt elektronische Bauelemente für Fahrzeuge sowie die Konsumenten- und Unterhaltungselektronik. Dazu gehören: **mikroelektromechanische Systeme (MEMS)** wie Beschleunigungs-, Druck-, Drehraten-, Umwelt-, Massefluss- und Magnetfeldsensoren, **anwendungsspezifische Schaltungen (ASICs)** und **Leistungshalbleiter**.
- ▶ **Fertigungsstandorte** Reutlingen (150-mm- und 200-mm-Technologie)
Dresden (300-mm-Technologie)
- ▶ **Patente** Bosch hält mehr als 1 500 Patente und Patentanmeldungen im Bereich der Halbleitertechnologie, 1 000 davon für die MEMS-Technologie.
- ▶ **Markt** Bosch fertigt MEMS-Sensoren, integrierte Schaltungen und Leistungshalbleiter für den Eigenbedarf. Große Teile des Portfolios werden auch am freien Markt angeboten.
- ▶ **Historie** Seit über 60 Jahren entwickelt und fertigt Bosch mikroelektronische Bauteile und Systeme. Die erste Fertigung einer Variode von Bosch begann 1958 in Stuttgart Feuerbach. Im Werk in Reutlingen fertigt das Unternehmen seit 1970 hochkomplexe integrierte Schaltungen. Bosch hat vor ca. 25 Jahren den Halbleiter-Fertigungsprozess für mikroelektromechanische Sensoren (MEMS-Sensoren) entwickelt und ist dort Weltmarktführer.

► Investitionen

Alleine für seine Halbleiterfertigungen in Reutlingen und Dresden hat Bosch seit der Einführung der 200-Millimeter-Technologie im Jahr 2010 mehr als 2,5 Milliarden Euro investiert. Hinzu kommen weitere Investitionen in Milliardenhöhe für die Entwicklung der Mikroelektronik.